



Messe-Trio rechnet mit rund 1.000 Ausstellern für 2012

Die 31. MOTEK Internationale Fachmesse für Montage-, Handhabungstechnik und Automation zählt bereits über 700 Aussteller; verfügbare Hallenflächen sind durch starken Andrang nahezu ausgebucht; 6. BONDexpo auf Wachstumskurs; 5. MICROSYS in den Startlöchern.



Mit dem Generalthema Industrial Handling und den komplementären Prozessketten-Themen Klebtechnologie sowie Mikrosystem- und Nanotechnologie nachdrücklich auf Erfolgskurs – auf diesen einfachen aber aussagekräftigen Nenner lässt sich die Entwicklung der MOTEK Internationale Fachmesse für Montage-, Handhabungstechnik und Automation bringen. 2012 geht die MOTEK bereits in ihre 31. Runde und bildet zusammen mit 6. BONDexpo Internationale Fachmesse für Klebtechnologie sowie der 5. MICROSYS Internationale Fachmesse für Mikrosystem- und Nanotechnologie ein weltweit einzigartiges Prozessketten-Trio, für das sich schon heute eine erneute Rekordbeteiligung abzeichnet.

MOTEK 2012 verzeichnet anhaltenden Buchungsbloom

Wenn jedoch allein die MOTEK schon über 700 und die BONDexpo weitere über 100 feste Buchungen aufweisen können, und wenn die MICROSYS – wegen der durch den Wechsel von Sinsheim nach Stuttgart vereinbarten Zwangspause – sich nun ebenfalls wieder im Aufwärtstrend befindet, dann scheint die Rekordmarke von deutlich über 1000 Ausstellern durchaus in Reichweite. Dazu meint der langjährige Projektleiter der MOTEK, Rainer Bachert: „Die zur MOTEK 2012 reservierten Hallen 1, 3, 5, 7 und 9 sind jetzt schon nahezu komplett belegt. Die Standeinplanung läuft auf Hochtouren, weil viele etablierte Aussteller größere Standflächen wünschen und wir schauen müssen, dass wir trotzdem die Wünsche aller Teilnehmer berücksichtigen können.“ Jürgen Handte, Projektreferent der BONDexpo und der MICROSYS ergänzt „dass sich die BONDexpo fest etabliert und mit über 100 Ausstellern in der Halle 7 ihren Platz hat. Es sind nicht nur nahezu alle Marktführer und auch eine ganze Reihe neuer Aussteller dabei, sondern es zeichnet sich ab, dass die Sparte Industrie-Klebebänder stärker denn je vertreten sein wird.“

Minitelle montieren und fügen – Synergieeffekte garantiert!

Überzeugt davon, dass die Mikrosystem- und Nanotechnologien in der Zukunft untrennbar mit den Themen der MOTEK wie der BONDexpo verbunden

sind, bleibt Schall mit der MICROSYS bei der Stange, und hilft diesen milliardenschweren Markt nach vorne zu entwickeln. Die Synergieeffekte zur MOTEK wie zur BONDexpo sind offensichtlich: So werden auf der MOTEK z.B. schon seit einigen Jahren Montage- und Handhabungs-Einrichtungen für mikrosystemtechnische Produkte gezeigt. Dasselbe gilt für die an der BONDexpo gezeigten Kleb-, Schäum- und Vergießstoffe auf Nanotechnologie-Basis, mit denen das rationelle und effiziente Fügen und Verbinden mikrosystemtechnischer Komponenten und baugruppen erst möglich wird.

Microsys – die Prozessketten-Fachmesse für Mikro- und Nanotechnologie

Der erfolgreiche Relaunch der Microsys, Fachmesse für Mikro- und Nanotechnik in der Entwicklung, Produktion, und Anwendung am Standort Stuttgart zeigte: Aussteller wie Besucher sehen einen dringenden Bedarf für eine Spezialmesse zum Thema Mikrotechnologie im unmittelbaren Einzugsgebiet Süddeutschland und Schweiz, wo ein Großteil der Anbieter und Anwender ansässig ist.

Um den Bedürfnissen der Microsys-Aussteller bestmöglich zu entsprechen, zieht das Messeunternehmen Schall an einem Strang mit den Institutionen, die sich ebenfalls für die Mikrosystemtechnik engagieren. Daher wird die Microsys als eigenständige Fachmesse seit 2010 im Wechsel mit dem Mikrosystemtechnik-Kongress in Darmstadt durchgeführt. In den Kongress-Jahren informiert die Microsys als „Themenpark Mikrosystemtechnik“ im Rahmen der MOTEK, Weltleitmesse für Montage-, Handhabungstechnik und Automation die Fachwelt.

Microsys – ein neuer Typ Prozessketten-Fachmesse

Turnusgemäß präsentiert sich die Microsys im Jahr 2012 wieder als eigenständige Fachmesse. Die parallel stattfindende MOTEK sowie die BONDexpo, Fachmesse für industrielle Klebtechnologie, platziert sie in ein ideales Umfeld und sorgt für wertvolle Synergien.



Die neu strukturierte und nunmehr 5. Microsys stellt die zukunftsorientierten Themen Mechatronik, Feinwerktechnik, Mikrosystem- und Nanotechnik sowie Mikroelektronik in den Vordergrund. Damit verkörpert sie einen zukunftssträchtigen, weil bereichsübergreifend angelegten Typ Prozessketten-Fachmesse wie er in dieser Form in der Branche einzigartig ist. Die einzelnen Bereiche Konstruktion, Materialwahl, Produktion, Prüftechnik, und Montage für Prototypen bis hin zur Serienfertigung werden praxisgerecht und zielgruppenorientiert präsentiert.

Microsys – Aussteller- und Fachbesucher-Zielgruppen

Als Aussteller sind international alle Hersteller bzw. Anbieter von Technologien, Produkten, Verfahren, Fertigungs-, Montage- und Prüfeinrichtungen, welche ▶

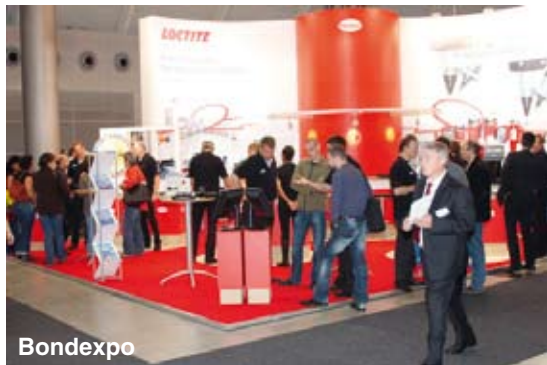
sich explizit für die Prozesskette „Konstruktion, Materialwahl, Produktion, Prüftechnik und Montage von Mechatronik-, Feinwerktechnik-, Mikrosystem- und Nanotechnik sowie Mikroelektronik“ eignen, angesprochen. Des Weiteren zählen zu den Aussteller-/Teilnehmerzielgruppen Hochschulen mit speziell orientierten Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen, Interessenverbände und Forschungsanstalten, öffentliche und private Institutionen, Cluster sowie Branchen-Organisationen, welche sich mit der anspruchsvollen Thematik befassen.

Die Fachbesucher-Zielgruppe der Microsys umfasst Forscher, Entwickler, Konstrukteure ebenso wie Produktions-, QS- und für die Beschaffung Verantwortliche sowohl aus Anbieter- als auch aus Anwender-Betrieben und –Einrichtungen. Da sich die Mikrosystem- und Nanotechnik künftig wie ein „roter Faden“ als wichtige Querschnittsaufgabe durch alle entwickelnden und/oder produzierenden Unternehmen zieht, birgt dieser Bereich ein enormes Potential für Investitionen, das künftig sicher noch weiter zunehmen wird.

8. - 11. Oktober 2012, Messe Stuttgart
www.motek-messe.de
www.bondexpo-messe.de
www.microsys-messe.de

Trade fair trio reckons with roughly 1000 Exhibitors in 2012

The 31st MOTEK international trade fair for handling, assembly and automation technology already has more than 700 exhibitors; available exhibition floor space is nearly booked out due to great demand; 6th BONDexpo on course for growth; 5th MICROSYS ready for the start.



Plainly headed for success with its general topic of industrial handling and complementary process sequence issues including bonding technology, microsystems and nano-technology – development of the MOTEK international trade fair for assembly, handling and automation technology can be reduced to this simple, yet highly expressive common denominator. MOTEK will enter its 31st round in 2012 and, together with the 6th BONDexpo international trade fair for bonding technology and the 5th MICROSYS international trade fair for microsystems and nano-technology, it represents a globally unique process-sequence trio for which record breaking participation is already becoming apparent today.

MOTEK 2012 registers sustained bookings boom.

However, the fact that alone MOTEK has already registered over 700 firm bookings, and BONDexpo more than an additional 100, and since MICROSYS is now experiencing an upswing as well due to the agreed upon forced interruption resulting from relocation from Sinsheim to Stuttgart, it would appear that the record of considerably more than 1000 exhibitors is entirely in reach. As expressed by long-standing MOTEK project manager Rainer Bachert: *“Halls 1, 3, 5, 7 and 9 have been reserved for MOTEK 2012, and they’re almost completely booked out. Booth allocation is running at full bore because many of our established exhibitors are requesting more booth floor space, and we’ll have to make sure that all participants are nevertheless satisfied.”* Jürgen Handte, project officer for BONDexpo and MICROSYS adds, *“BONDexpo has become very well established and will take place with more than 100 exhibitors in hall 7. Not only will all of the market leaders and lots of new exhibitors be on hand, it’s also becoming clear that the industrial adhesive tape sector will be represented to a greater extent than ever before.”*



Assembling and Joining Miniature Parts – Guaranteed Synergy Effects!

Convinced that microsystems and nano-technology will remain inseparably linked to the topics covered by MOTEK and BONDexpo in the future as well, private trade fair promoters P. E. Schall GmbH & Co. KG intend to stick it out and help this billion Euro market generate forward development. Synergy effects with MOTEK and BONDexpo are obvious: For example, assembly and handling units for microsystems technology have already been on exhibit at MOTEK for several years. The same applies to the adhesives, foams and encapsulating materials presented at BONDexpo which are based on nanotechnologies, and by means of which streamlined and efficient joining and bonding of microsystems components is made possible in the first place.

Microsys – the Process Sequence Trade Fair for Micro and Nano-Technology

The successful relaunch of the Microsys trade fair for micro and nano-technology in R&D, production and applications engineering at its venue in Stuttgart has demonstrated that exhibitors and visitors perceive an urgent need for a specialised trade fair covering micro-technology in the catchment area spanning Southern Germany and Switzerland, where a large percentage of the suppliers and users are located.

In order to fulfil the requirements of Microsys exhibitors as well as possible, trade fair promoters P.E. Schall GmbH & Co. KG are joining forces with the institutions who are also actively involved with microsystems technology. And thus Microsys has



BONDexpo 2012



been promoted since 2010 as an independent trade fair held every other year in alternation with the Microsystems Technology Convention in Darmstadt. In the years during which the convention take place, Microsys disseminates information as a "Microsystems Technology" theme park within the framework of MOTEK, the leading international trade fair for handling, assembly and automation technology.

Microsys – a New Type of Process Sequence Trade Fair

According to this schedule, Microsys will be promoted as an independent trade fair again in 2012. The concurrently held MOTEK, as well as the BONDexpo trade fair for industrial bonding technology, provide an ideal setting for Microsys and offer valuable synergies.

The newly structured 5th Microsys will emphasise the future oriented issues of mechatronics, precision mechanics, microsystems and nano-technology, as well as microelectronics. And thus, thanks to its interdisciplinary approach, the event embodies a highly promising process sequence trade fair

which is entirely unique within the industry in its current form. The individual fields of design engineering, material selection, production, test technology and assembly of prototypes, right on up to series manufacturing, will be presented in a highly practical, target group oriented fashion.

Exhibitor and Expert Visitor Target Groups

All manufacturers and suppliers of technologies, products and processes, as well as production, assembly and test equipment, which are explicitly suitable for the process sequence covering engineering, material selection, manufacturing, test technology and assembly for mechatronic, precision mechanical, microsystems and microelectronic technologies, are targeted around the world. Exhibitor/participant target groups also include universities with specially oriented training and research facilities, interest groups and research institutes, public and private institutions, as well as clusters and industry organisations which deal with these demanding issues.

The Microsys visitor target-group includes researchers, product developers and R&D engineers, as well as production, QA and procurement managers from service providers and user operations and facilities. Due to the fact that microsystems technology and nano-technology will be the central thread which runs through all developing and/or manufacturing companies as an essential, multi-divisional task in the future, this field of endeavour harbours enormous potential for investment, which will surely continue to grow in the future.

8 to 11 October 2012 at Stuttgart Exhibition Centre
www.motek-messe.de
www.bondexpo-messe.de
www.microsys-messe.de

Auslandvertretungen - Représentations - Agents

Schweiz und Liechtenstein:

Hermann Jordi
 Jordi Publipress
 Postfach 154 - CH-3427 Utzenstorf
 T. 0041-3 26 66 30 90
 F. 0041-3 26 66 30 99
info@jordipublipress.ch
www.jordipublipress.ch

Italien:

Edgar Mäder
 Emtrad s.r.l.
 Via Duccio Galimberti 7
 I-12051 Alba (CN)
 T. 0039-01 73 28 00 93
 F. 0039-01 73 28 00 93
info@emtrad.it
www.emtrad.it

Belgien, Niederlande und Luxemburg:

Sigrid Jahn - Jens Paulisch
 Intermundio BV
 Postbus 63558 - NL-JN Den Haag
 T. 0031-70 36 02 39 0
 F. 0031-70 36 02 47 4
info@intermundio.com
www.intermundio.com

Frankreich:

Evelyne Gisselbrecht
 33 Rue du Puy-de-Dôme
 F-63370 Lempdes
 T. 0033-4 73 61 95 57
 F. 0033-4 7361 96 61
evelyne.gisselbrecht@laposte.net

P.E. Schall GmbH & Co. KG
Gustav-Werner-Straße 6 • D-72636 Frickenhausen
Telefon +49 (0) 7025 9206-0 • Telefax +49 (0) 7025 9206-620
info@schall-messen.de • www.schall-messen.de